

Informations générales :

Wafer de verre (Bk7, 1mm d'épaisseur)

Procédé de fabrication

- 1) Nettoyage du substrat
- 2) Structuration de la sous-couche par lift-off et pulvérisation cathodique
 - Dépôt résine AZ5214E réversible + Photolithographie
 - Pulvérisation cathodique Ti/Ni puis complément Ti/Cu
- 3) Dépôt de résine AZ4562 épaisseur 35 μm (en dehors utilisation recommandée constructeur)
- 4) Croissance électrolytique de nickel.
- 5) Enlèvement du moule et croissance électrolytique de cuivre pleine plaque
- 6) Gravure et Polissage
 - Dépôt résine épaisse AZ4562
 - Gravure humide du cuivre
- 7) Répétitions des étapes 3 à 6 pour faire plusieurs couches
- 8) Gravure finale du cuivre

